

产品说明书

TACFlux® 108HF

简介

TACFlux® 108HF 是一款专为 SnAgCu 和 SnAg 无铅合金配制的卤素免洗型助焊剂。在空气或氮气气氛下可提供出色的润湿能力。

属性

行业标准测试结果	
测试	结果
助焊剂类型	ROM0
满足 IEC 61249-2-21 标准 EN14582 测试方法的无卤要求	氯 < 900ppm 溴 < 900ppm 氯 + 溴 < 1,500ppm
典型黏度*	10kcps
典型粘力	135g
典型酸值	155mg KOH/g
表面绝缘电阻 SIR (基于 J-STD-004B 的测试要求)	通过
电迁移 ECM (基于 J-STD-004B 的测试要求)	通过
助焊剂诱发的腐蚀(铜镜测试)	通过
腐蚀	通过

*Brookfield 锥板 (CP51, 转速 5 rpm, 5 分钟, 25°C)。

附加测试结果	
测试	结果
外观	淡黄色-琥珀色
最高回流温度	260°C
回流气氛	空气或氮气
保质期	6 个月 (0-30°C)
储存条件	在 0-30°C 环境下储存 (注射器装或筒装应尖头朝下)

所有信息仅供参考, 不作为订购产品的规格说明。

包装

TACFlux® 108HF 通常使用 10cc 和 30cc 的注射器包装或 100g 罐装; 其他包装也可应求提供。

清洁

TACFlux® 108HF 专为免洗应用设计。如果需要, 可用市售助焊剂清洗剂去除。

回流

在空气或氮气回流气氛中, TACFlux® 108HF 的回流峰值温度应低于 260°C。

储存

筒装或注射器包装的 TACFlux® 108HF 应尖头朝下, 储存在 0-30°C 的环境中。如果冷藏储存, 应在使用前 4 小时从冷藏环境中取出解冻至室温。

技术支持

钢泰公司拥有经验丰富的应用工程师提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面, 可以在焊料性能、合金兼容性以及预成型焊片、焊锡丝、焊带和焊锡膏的选择方面提供专业性的建议。

安全说明书

请参考随货品一起寄出的产品安全说明书, 或者联络钢泰公司当地的销售团队获取。

本产品说明书仅供参考, 并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明, 钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证。钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司。

From One Engineer To Another®

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

亚洲 +65 6268 8678 • 中国 +86 (0) 512 628 34900 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



表格编号: 99698 (SC A4) R0



©2023 钢泰公司